



平成 22 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 EMCOM ホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 竹内 秀人  
 (JASDAQ・コード 7954)  
 問合せ先 取締役管理本部長 三井 規彰  
 電 話 03-5412-6100

(経過報告)借入金の一部返済に関するお知らせ

当社は、本日、借入債務(元本3,463百万円)の一部について返済手続きを行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 借入金の一部返済の経緯

当社は、平成 22 年 3 月 17 日付「(経過報告)返済に関する合意書締結並びに借入金の一部返済に関するお知らせ」において発表しておりますが、同日付にて、平成 21 年 5 月 29 日付「準消費貸借契約 (REPLACEMENT LOAN AGREEMENT)」および、平成 21 年 7 月 6 日付「準消費貸借契約の修正契約 (AMENDMENT AGREEMENT TO REPLACEMENT LOAN AGREEMENT)」(以下、「本件ローン契約」という。)に係る合意書を締結し、本日、合意事項に基づき、借入債務(元本 3,463 百万円)の一部について返済手続きを実施いたしました。

2. 本日付返済手続きの内容

資金調達方法	資金調達額	返済手続日	返済額	債務残高(元本)
-	-	-	-	3,463 百万円
自己資金	100 百万円	平成 22 年 4 月 27 日	100 百万円	3,363 百万円 ※
合 計	100 百万円	-	100 百万円	-

※ 本日時点(返済手続き後)の元本残高

3. 債権者との間で合意している今後の返済内容(計画)

返済予定日	返済原資	返済額	債務残高
-	-	-	3,363 百万円
平成 22 年 5 月 末日	グループ会社からの借入を含	400 百万円	2,963 百万円

平成 22 年7月末日	む自己資金並びに、資金調達により返済原資を確保する 予定 ※	1,963 百万円	1,000 百万円
平成 22 年8月 15 日		1,000 百万円	-
-	-	3,363 百万円	-

※ 資金調達につきましては、具体的な内容が決定され次第、適時適切にお知らせいたします。

#### 4.今後の見通し

当社は、債権者との間で締結した本件ローン契約に係る合意書締結により、延滞は解消しておりますが、本合意書を順守し借入債務を完済するため、返済原資の早期全額確保に向けて当社グループの役職員一同、全力で事業に邁進するとともに、資金調達の方法についても早期実現を目指してまいります。

以 上